

强于大市

半导体行业周报

全球半导体设备交付期延长至 14 个月

半导体行业景气依然高企，下游需求火热，芯片交付时间超过 20 周，供应短缺没有缓解迹象。上周共有 5 家半导体公司发布年中报业绩，其中 4 家净利润同比增长超过 40%。全球经济数字化和万物互联仍旧是半导体行业的发展主题，国产替代将驱动国内半导体企业全面成长。

行业动态：

- **中报业绩全线向好：**上周共有 5 家半导体企业披露 2021 上半年业绩报告，其中仅寒武纪录得亏损，系研发投入高企所致。其余 4 家半导体企业均实现了 40% 以上的净利润增长。从公司业绩变动的归因来看，多数企业业绩增长来自下游需求带动，预计行业将持续保持高景气。
- **目前共有 103 家半导体企业正在 IPO，模拟+射频频的艾为电子本周上市交易。**上周新增封测企业蓝箭电子、电子材料企业兴福电子开启上市辅导；EDA 企业国微思尔芯完成上市辅导；功率半导体设计企业中车电气、功率半导体设计企业宏微科技成功注册。
- **半导体设备：设备交付期拉长，需求保持旺盛。**据韩媒 The Elec 的设备交付周期研究报道，截止 7 月 ASML 的 ArF 设备交付期达 24 个月、I-line 和极紫外光刻设备均为 18 个月，TEL、AMAT、Lam 等的核心工艺设备的平均交付期延长至 14 个月。盛美半导体二季度业绩电话会议纪要显示，公司坚定技术差异化、产品平台化、客户国际化战略，让客户从公司产品、技术中受益。
- **晶圆代工：新唐科技晶圆代工价格 9 月将上涨 15%，绍兴中芯获一土地受让将于 2022 年 8 月开工。**据中国台湾 MCU 大厂新唐科技向客户发出的涨价函，3 季度晶圆片供需仍处于失调状态，计划将于 9 月 1 日起晶圆代工价格在现行价格基础上提高 15%，未上线订单也将按照调整后的价格执行。据浙江省自然资源厅公示的绍兴中芯土地招拍挂出让结果显示，开工时间为 2022 年 8 月 26 日，竣工时间为 2024 年 8 月 26 日，历时两年，另据绍兴中芯已进入了 IPO 辅导期拟募资扩充产能，二期拟扩产至 10 万片/月。目前晶圆产能供需紧张关系仍未缓解，仍有价格上涨现象，晶圆厂扩张活动有序进行，后续需关注设备进场进度和扩产的配合情况。
- **芯片：供应短缺没有缓解迹象。**根据 Susquehanna Financial Group 的研究，芯片交付周期在 7 月份达到 20.2 周，比上月增加超过 8 天。这是该公司 2017 年开始跟踪相关数据以来的最长等待时间。其中，汽车、工业设备和家用电子产品所用的逻辑芯片短缺状况在 7 月份加剧，交付周期达 26.5 周，以往数据多是 6-9 周。预计芯片供应将持续偏紧。
- **半导体材料：光刻胶国产化持续推进。**光刻胶国产化进程仍在推进，根据南大光电 8 月 15 日在互动易平台回复，公司已经建成 25 吨 ArF 光刻胶生产线，现有小批量订单生产。目前国内缺乏 ArF 光刻胶规模量产经验，产品配套产业链上的诸多技术难点需要公司技术部门自主攻关，解决技术和工艺瓶颈。后续需关注国产 ArF 光刻胶订单情况。

投资建议：

- **设备组合：**中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技；建议关注：晶盛机电
- **材料组合建议关注：**沪硅产业、雅克科技、安集科技、立昂微、彤程新材、晶瑞电材、中环股份、鼎龙股份
- **功率半导体组合：**新洁能、华润微；建议关注：斯达半导、士兰微、闻泰科技
- **模拟建议关注：**圣邦股份、思瑞浦、卓胜微（射频）
- **MCU：**兆易创新；建议关注中颖电子
- **其他：**韦尔股份；建议关注：三安光电、乐鑫科技、恒玄科技

风险提示

- 疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；半导体材料国内市场增速放缓；美国进一步向中国禁售关键半导体设备。

相关研究报告

《盛美半导体（ACMR）21Q2 业绩点评及电话会议纪要：坚定技术差异化、产品平台化、客户国际化战略，让客户从公司产品、技术中受益》20210813

《半导体新股系列 8—格科微（688728）：全球 CIS 龙头，拟自建 2 万片/月 12 英寸 BSI 晶圆后道工序》20210811

《半导体行业周报：业绩全线高增长，设备交付期延长至 1-2 年》20210809

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

半导体

证券分析师：杨绍辉

(8621)20328569

shaohui.yang@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300514080001

证券分析师：余嫻嫻

(8621)20328550

yuanyuan.yu@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300517050002

证券分析师：王达婷

(8621)20328284

dating.wang@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300519060001

目录

半导体企业 2021 上半年业绩报告汇总.....	4
拟 IPO 的半导体企业汇总	5
行业数据回顾	8
上周信息汇总	12
IP & EDA.....	12
半导体设备	12
半导体材料	13
晶圆代工	13
封测	13
功率半导体	13
风险提示.....	14

图表目录

图表 1. 上周 2021 上半年半导体企业业绩公告统计表.....	4
图表 2. 半导体拟 IPO 统计表（截止 2021/08/15）	5
续图表 2. 半导体拟 IPO 统计表（截止 2021/08/15）	6
续图表 2. 半导体拟 IPO 统计表（截止 2021/08/15）	7
图表 3. 全球半导体销售额当月值.....	8
图表 4. 北美半导体设备制造商出货额:当月值（百万美元）	8
图表 5. 日本半导体设备制造商出货额:当月值（百万美元）	9
图表 6. 美国与国内半导体指数对比	9
图表 7. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比（美元）	9
图表 8. 美国与国内半导体指数对比(近十周涨跌幅)	9
图表 9. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比（美元）	9
图表 10. 申万半导体材料指数.....	10
图表 11. 全球半导体级硅片出货量	10
图表 12. 半导体器件封装材料进出口金额	11
图表 13. 半导体器件封装材料进出口单价	11
图表 14. 本周半导体设备与材料涨跌幅前五个股.....	11

半导体企业 2021 上半年业绩报告汇总

截止 2021/8/15，半导体行业下游需求旺盛，企业盈利能力大幅提升。上周共有 5 家半导体企业披露 2021 上半年业绩报告，其中仅寒武纪录得亏损，系研发投入高企所致。其余 4 家半导体企业均实现了 40% 以上的净利润增长。从公司业绩变动的归因来看，多数企业业绩增长来自下游需求带动，预计行业将持续保持高景气。

图表 1. 上周 2021 上半年半导体企业业绩公告统计表

序号	类别	证券代码	证券简称	归属于上市公司 股东净利润	同比增长 (%)	业绩变动归因	披露时间
1	材料	300398.SZ	飞凯材料	盈利：1.68 亿元	52.25	随着我国疫情得到有效控制，全球供应链需求向国内转移，使得公司下游市场需求大幅增加，公司本期业务实现了较大的增长。	8 月 10 日
2	设计	688256.SH	寒武纪-U	亏损：3.9 亿元	(94)	公司为进一步推进“云边端”产业布局、保持在行业内的核心竞争优势，积极引进高端优秀人才，增加产品线的研发投入。	8 月 12 日
3	材料	002859.SZ	洁美科技	盈利：2.23 亿元	53.36	消费电子、新能源汽车和 5G 技术应用的需求激增和加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强，公司订单量充足，产销两旺，纸质载带和胶带、塑料载带以及离型膜三大业务板块均有较好的表现。	8 月 14 日
4	设计	688661.SH	和林微纳	盈利：0.54 亿元	148.48	公司不断拓展海内外客户，产品服务不断提升以满足客户群体对整体解决方案的需求。营业收入的增长主要由公司半导体芯片测试探针业务所驱动	8 月 14 日
5	设计	688123.SH	聚辰股份	盈利：0.66 亿元	41.2	公司产品销售随着下游终端应用市场需求逐步回暖呈良好恢复态势，且间接持有中芯国际约 355.02 万股股份的公允价值变动收益增加约 0.22 亿元。	8 月 16 日

资料来源：公司公告、中银证券

拟 IPO 的半导体企业汇总

截止 2021/8/15，共有 103 家半导体企业申报 IPO、开展上市辅导等。本周新增封测企业蓝箭电子、电子材料企业兴福电子开启上市辅导；EDA 企业国微思尔芯完成上市辅导；功率半导体设计企业中车电气、功率半导体设计企业宏微科技成功注册。

图表 2. 半导体拟 IPO 统计表（截止 2021/08/15）

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
1	格科微	已注册	中金公司	2003	设计	CMOS 图像传感器、显示驱动芯片
2	普冉股份	已注册	中信证券	2016	设计	超低功耗 Flash 存储器、高安全 Flash 存储器、高可靠性 EEPROM 存储器
3	中车电气	已注册	中金公司	2005	设计	功率半导体
4	宏微科技	已注册	民生证券	2006	设计	以 IGBT、FRED 为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组
5	雷电微力	已注册	中信证券	2007	设计	高性能微波及射频 SOC 集成电路
6	力芯微	已注册	光大证券	2002	设计	模拟芯片：电源管理芯片、
7	华海清科	提交注册	国泰君安	2013	设备	CMP 设备
8	盛美股份	提交注册	海通证券	2005	设备	清洗设备、FN、镀铜设备等
9	灿勤科技	提交注册	中信建投	2004	设计	微波介质陶瓷元器件
10	炬芯科技	提交注册	申万宏源	2014	设计	蓝牙音频 SoC 芯片系列、便携式音视频 SoC 芯片系列、智能语音交互 SoC 芯片系列等
11	东芯股份	提交注册	海通证券	2014	设计	24nm NAND、48nm NOR
12	【苏州】国芯科技	提交注册	国泰君安	2001	设计	国产自主 32 位高性能嵌入式 CPU 开发、嵌入式产品设计和应用
13	安路科技	提交注册	中金公司	2011	设计	可编程逻辑器件（FPGA）、可编程系统级芯片（SoC）、及相关 EDA 软件工具和创新系统解决方案
14	翱捷科技	提交注册	海通证券	2015	设计	全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片
15	创耀科技	过会	海通证券	2006	设计	通信芯片
16	云天励飞	过会	中信证券	2014	设计	AI 芯片
17	芯龙半导体	问询	海通证券	2007	设计	电源管理类模拟集成电路
18	芯导科技	问询	国元证券	2009	设计	功率
19	华卓精科	问询	东兴证券	2012	零部件	光刻机双工件台
20	中图科技	问询	申万宏源	2013	材料	图形化蓝宝石衬底
21	屹唐股份	问询	国泰君安、中金公司	2015	设备	刻蚀、去胶、退火
22	希荻微	问询	民生证券、中金公司	2012	设计	高性能模拟集成电路
23	芯导电子	问询	国元证券	2009	设计	功率半导体
24	英集芯科技	问询	华泰联合	2014	设计	数模混合集成电路芯片
25	江波龙	问询	中信建投	1999	设计	嵌入式存储、固态硬盘存储、微存储、汽车存储等
26	东微半导体	问询	中金公司	2008	设计	高性能功率器件
27	莱特光电	问询	中信证券	2010	材料	OLED 有机材料
28	华大九天	问询	中信证券	2009	软件	EDA 软件
29	唯捷创芯	问询	中信建投	2010	设计	射频前端及高端模拟芯片
30	龙芯中科	问询	中信证券	2010	设计	CPU
31	天岳先进	问询	海通证券	2010	材料	半绝缘型和导电型碳化硅衬底
32	纳芯微	问询	光大证券	2013	设计	车规级传感器及信号链芯片
33	晶合集成	问询	中金公司	2015	设计	面板驱动芯片
34	必易微	问询	申万宏源	2009	设计	高性能模拟及混合信号集成电路
35	长光华芯	问询	华泰联合	2012	设计	高功率半导体激光器芯片等
36	炬光科技	问询	中信建投	2007	设计	高功率半导体激光器及微光学相关产品
37	思科瑞	问询	中国银河证券	2014	测试	分立器件及晶圆测试
38	麦斯克	问询	国泰君安	1995	材料	硅片
39	甬矽电子	问询	平安证券	2019	封测	封测
40	比亚迪半导体	问询	中金公司	2004	设计	功率半导体

资料来源：上交所、深交所、公司官网、中银证券

续图表 2. 半导体拟 IPO 统计表 (截止 2021/08/15)

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
41	赛微微	问询	国泰君安	2009	设计	电源管理芯片
42	概伦电子	问询	招商证券	2010	软件	EDA 软件
43	中微股份 (深圳)	问询	中信证券	2001	设计	混合信号 SoC
44	龙腾半导体	问询	国信证券	2009	设计	新型功率半导体器件
45	盛景微	问询	光大证券	2016	设计	物联网控制芯片
46	臻镭科技	问询	中信证券	2015	设计	射频芯片、电源管理芯片
47	思特威	问询	中信建投	2011	设计	CMOS 图像传感器芯片
48	天德钰	问询	中信证券	2010	设计	智能移动终端显示屏驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片、快速充电协议芯片、电子价签驱动芯片及解决方案
49	奥比中光	问询	中信建投	2013	设计	深度引擎数字芯片、专用感光模拟芯片
50	好达电子	问询	安信证券	1999	设计	SAW Filter
51	烨映微	问询	海通证券	2016	设计	MEMS 非制冷热电堆红外传感器
52	沈阳拓荆	问询	招商证券	2010	设备	薄膜沉积设备
53	峰岷科技	问询	海通证券	2010	设计	电机驱动控制芯片
54	广立微	问询	中金公司	2003	软件/设备	EDA 软件、电路 IP、晶圆级电性测试设备
55	上海微	问询		2002	设备	光刻机
56	毓昌科技	已申报	国信证券	2010	设计	微波毫米波射频芯片
57	金海通	已申报	海通证券	2012	设备	高温 IC 自动测试 Pick-Place 分选机
58	路维光电	已申报	国信证券	2012	材料	掩模板
59	国博电子	完成上市辅导	招商证券	2010	设计	射频
60	艾森半导体	完成上市辅导	华泰联合	2010	材料	光刻胶及配套高纯化学品
61	国微思尔芯	完成上市辅导	中金公司	2003	软件	EDA
62	江苏影速	上市辅导	中金公司	2014	设备	激光直写的光刻机设备
63	矽电半导体	上市辅导	招商证券	2003	设备	探针台
64	中科飞测	上市辅导	国泰君安	2014	设备	量测设备
65	海光信息	上市辅导	中信证券	2014	设计	CPU
66	苏州赛芯微	上市辅导	国泰君安	2009	设计	模拟芯片
67	耐科装备	上市辅导	国元证券	2005	设备	半导体封装装备
68	上海伟测	上市辅导	平安证券	2016	测试	晶圆测试和芯片成品测试
69	芯动联科	上市辅导	中信建投	2012	设计	MEMS
70	芯微电子	上市辅导	国金证券	1998	设计	功率半导体分立器件
71	禹龙通	上市辅导	招商证券	2005	设计	大功率射频电阻, 同轴负载、衰减器、波导系列无源器件、碳化硅及橡胶板吸波材料
72	吉莱电子	上市辅导	长江证券	2001	设计	单、双向晶闸管全系列, 低频功率三极管、单、双向 TVS 保护管、双向 (防静电) 放电管
73	富创精密	上市辅导	中信证券	2008	零部件	半导体设备精密零部件加工制造及表面处理
74	源杰半导体	上市辅导	国泰君安	2013	设计	激光器芯片
75	【杭州】国芯科技	上市辅导	中信证券	2001	设计	数字电视芯片、面向物联网人工智能芯片
76	新顺微电子	上市辅导	华泰联合	2002	设计	功率半导体
77	微源半导体	上市辅导	海通证券	2010	设计	电源管理芯片
78	南麟电子	上市辅导	国金证券	2004	设计	模拟和数模混合类集成电路的设计与研究
79	芯天下	上市辅导	中信建投	2014	设计	NOR Flash
80	灿芯半导体	上市辅导	海通证券	2008	软件	定制化芯片 (ASIC) 设计方案提供商及 IP 供应商
81	杰华特	上市辅导	中信证券	2013	设计	电源管理芯片
82	安凯微电子	上市辅导	东方证券	2000	设计	物联网摄像机核心芯片、蓝牙芯片以及应用处理器芯片
83	易兆微	上市辅导	海通证券	2014	设计	短距离无线通讯芯片
84	辉芒微	上市辅导	中信证券	2005	设计	专注于非易失性存储芯片(NVM)、数模混合信号设计、高端模拟电路、高压电源管理芯片
85	飞驒科技	上市辅导	中金公司	2015	设计	射频芯片
86	通美晶体	上市辅导	海通证券	1998	材料	砷化镓、磷化铟等在内的 III-V 族化合物及单晶锗半导体衬底材料

资料来源: 上交所、深交所、公司官网、中银证券

续图表 2. 半导体拟 IPO 统计表 (截止 2021/08/15)

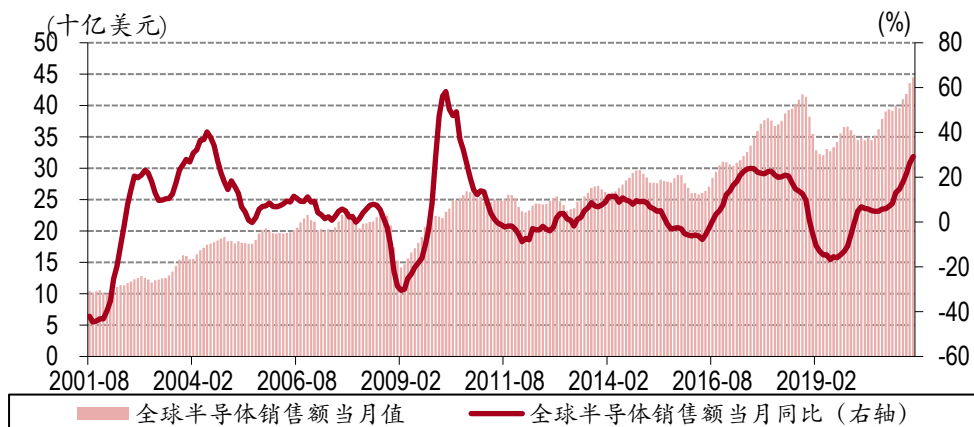
序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
87	蕊源半导体	上市辅导	中金公司	2016	设计	电源管理
88	上海超硅	上市辅导	中金公司	2008	材料	大硅片
89	汇成真空	上市辅导	东莞证券	2006	设备	真空应用设备
90	中巨芯	上市辅导	海通证券	2017	材料	电子湿化学品、电子特种气体、半导体前驱体
91	锐成芯微	上市辅导	华泰联合	2011	软件	IP 授权
92	新恒汇电子	上市辅导	平安证券	2017	封测/材料	晶圆测试减划、封装材料高精度蚀刻金属引线框架、物联网 eSIM 封装
93	映日科技	上市辅导	安信证券	2015	材料	靶材
94	绍兴中芯	上市辅导	海通证券	2018	代工	专注于功率、传感和传输应用, 特色工艺集成电路芯片及模块封装的代工服务的制造商
95	有研半导体	上市辅导	中信证券	2001	材料	硅片
96	京仪装备	上市辅导	国泰君安	2016	设备	半导体温控装置系列 (Chiller)
97	盛科通信	上市辅导	中金公司	2019	设计	以太网交换芯片
98	思必驰	上市辅导	中信证券	2007	设计	AI 芯片
99	欣盛半导体	上市辅导	中信建投	2016	IDM	COF 封装显示驱动芯片
100	振华风光	上市辅导	中信证券	2005	IDM	高可靠半导体模拟集成电路
101	蓝箭电子	上市辅导	金元证券	1998	封测	封装的双极型晶体管、场效应晶体管、集成电路 (IC)、LED 及 LED 照明灯具
102	兴福电子	上市辅导		2008	材料	电子级磷酸、电子级硫酸、蚀刻液、剥膜液、显影液、光阻稀释剂、清洗液、再生剂等湿电子化学品

资料来源: 上交所、深交所、公司官网、中银证券

行业数据回顾

6月全球半导体销售额达445.3亿美元，同比增长29.2%。根据美国半导体产业协会数据，6月全球半导体销售额继续保持增长，较5月增长2.1%，2021年1-6月全球半导体销售额增长13.71%。

图表 3. 全球半导体销售额当月值



资料来源：Wind，美国半导体产业协会，中银证券

6月北美半导体设备出货金额36.7亿美元，连续六个月创新高。据SEMI统计，6月北美半导体设备出货金额继续创新高，较5月的35.9亿美元提升2.3%，较2020年同期23.2亿美元上升58.4%。2021年1-6月份出货额的环比增幅分别为13.3%、3.5%、4.2%、4.7%、4.7%、2.3%。

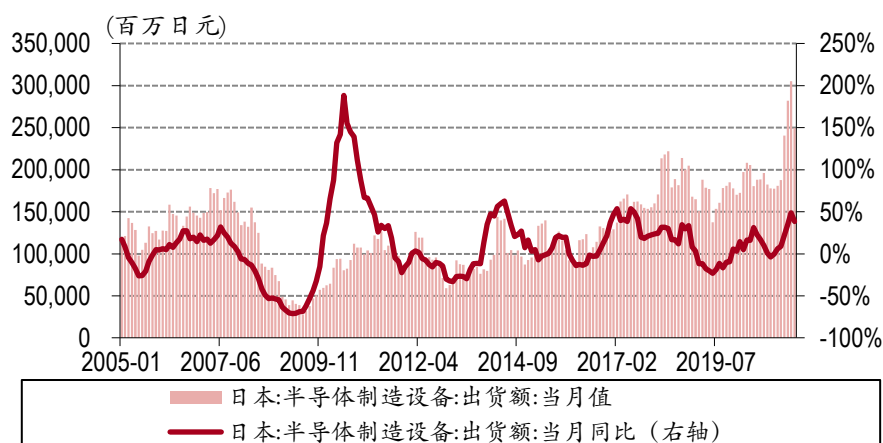
图表 4. 北美半导体设备制造商出货额:当月值（百万美元）



资料来源：Wind，SEMI，中银证券

6月日本半导体设备出货金额2495亿日元，同比增长38%。据日本半导体制造装置协会统计，6月日本半导体设备出货金额有所回落，较5月的3054亿日元下降18.3%，相比于2020年同期1804亿日元仍上升38%。2021年1-6月份出货额的环比增幅分别为1.9%、3.7%、28.4%、17.2%、8.3%、-18.3%。

图表 5. 日本半导体设备制造商出货额:当月值 (百万美元)



资料来源: Wind, 日本半导体制造装置协会, 中银证券

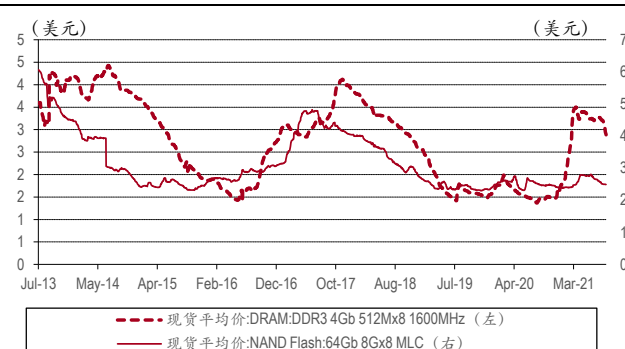
国内国外半导体指数均有所回落, 存储周度价格小幅回调。近一周申万行业半导体指数报 6559.49, 下跌 6.6%, 但仍保持在历史高位水平。费城半导体指数也有所下滑, 收报 3335.04 点, 下跌 2.3%。近一周存储现货平均价较前期继续下行, NAND Flash 64Gb 8Gx8 MLC 价格连续下滑并在上周下跌 5.9%, 跌幅继续创新高, DRAM:DDR3 4Gb 512Mx8 1600MHz 价格较上周下跌 0.3%, 连续第 5 周录得下跌。

图表 6. 美国与国内半导体指数对比



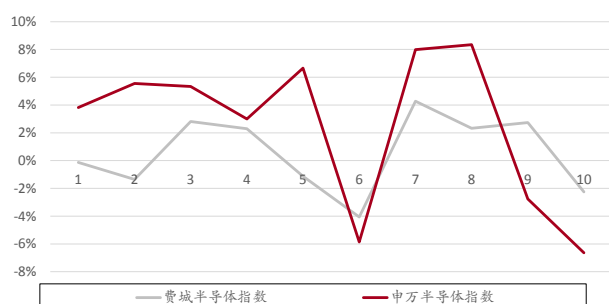
资料来源: 万得, 中银证券

图表 7. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比 (美元)



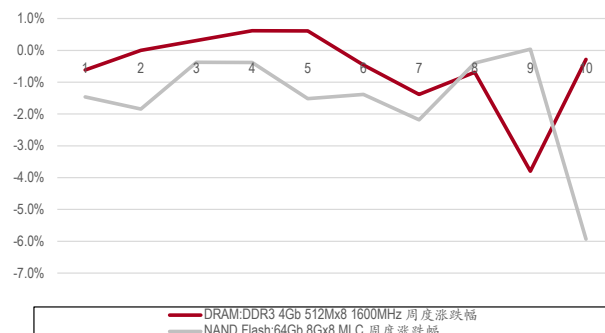
资料来源: 万得, 中银证券

图表 8. 美国与国内半导体指数对比(近十周涨跌幅)



资料来源: 万得, 中银证券

图表 9. DRAM 与 NAND Flash 现货平均价格对比 (美元)



资料来源: 万得, 中银证券

本周申万半导体材料指数收报 10333 点, 较上周下降 5.6%。年初至今, 申万半导体材料指数已上涨 71.7%, 7 月 30 日达到近期峰值 12438 点, 进入 8 月后指数略有下调或逐步进入调整期。

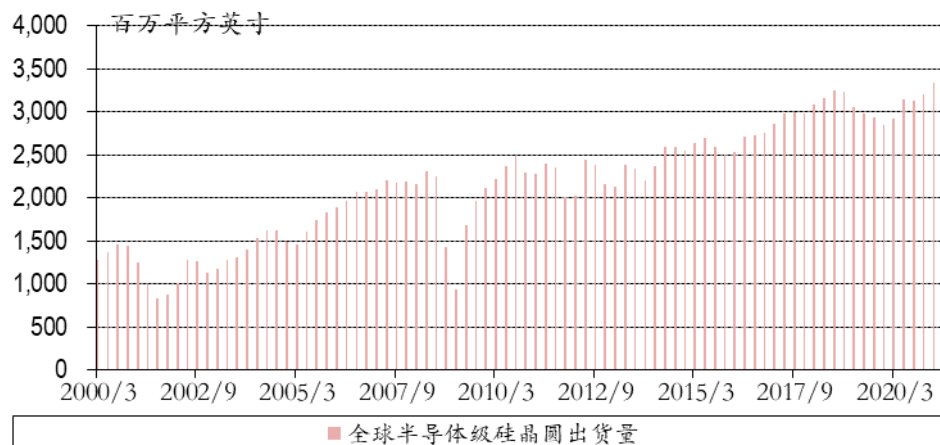
图表 10. 申万半导体材料指数



资料来源: Wind, SEMI, 中银证券

硅晶圆: 根据 SEMI 数据, 2021 年第二季度全球半导体级硅晶圆出货量达 3534 百万平方英寸, 同比增长 12.1%, 全球半导体级硅晶圆出货量屡创新高。

图表 11. 全球半导体级硅片出货量



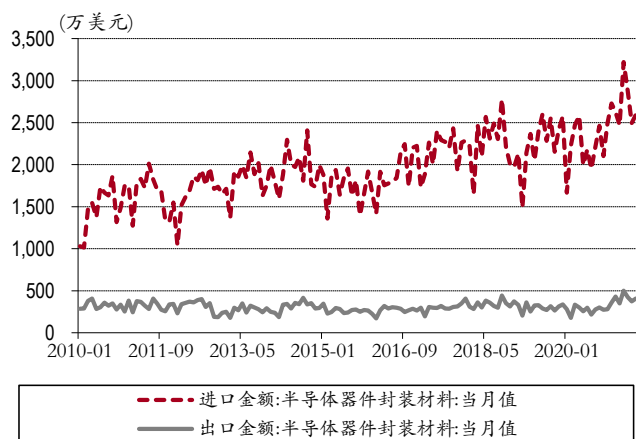
资料来源: SEMI, 中银证券

光刻胶: 光刻胶国产化进程仍在推进, 根据南大光电 8 月 15 日在互动易平台回复, 公司已经建成 25 吨 ArF 光刻胶生产线, 现有小批量订单生产。目前国内缺乏 ArF 光刻胶规模量产经验, 产品配套产业链上的诸多技术难点需要公司技术部门自主攻关, 解决技术和工艺瓶颈。后续需关注国产 ArF 光刻胶订单情况。

湿电子化学品: 国内湿电子化学品进入产能集中扩张期, 晶瑞电材 3 万吨高纯硫酸技改项目已建成, 三大湿电子化学品 (高纯硫酸、高纯双氧水、高纯氨水) 已达到 G5 级别。

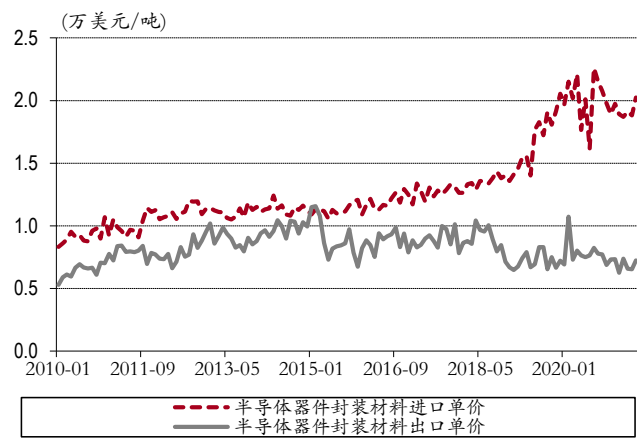
封装材料: 根据海关总署数据, 2021 上半年半导体器件封装材料进口单价上涨 7%, 出口单价基本持平, 整体进口金额不断走高, 封装材料亟待国产化。

图表 12. 半导体器件封装材料进出口金额



资料来源: 万得、海关总署、中银证券

图表 13. 半导体器件封装材料进出口单价



资料来源: 万得、海关总署、中银证券

图表 14. 本周半导体设备与材料涨跌幅前五个股

代码	简称	涨幅 (%)	代码	简称	跌幅 (%)
600141.SH	兴发集团	22.05	688521.SH	芯原股份-U	(14.38)
688661.SH	和林微纳	21.36	605358.SH	立昂微	(13.49)
688233.SH	神工股份	12.84	688981.SH	中芯国际	(13.46)
688106.SH	金宏气体	11.19	688536.SH	思瑞浦	(11.31)
600360.SH	华微电子	4.02	300346.SZ	南大光电	(8.46)

资料来源: 万得, 中银证券

上周信息汇总

IP & EDA

【国微思尔芯】专注数字芯片 EDA 领域，国微思尔芯完成科创板上市辅导

8月10日消息，中金公司于8月6日发布了“关于上海国微思尔芯技术股份有限公司（简称“国微思尔芯”）辅导工作总结报告公示”，宣布国微思尔芯已符合拟发行上市公司规范运行的要求，已具备了辅导验收及在科创板 IPO 上市的申请条件。

（资料来源：集微网）

【行业】广东省制造业高质量发展“十四五”规划：到2025年半导体及集成电路产业营收突破4000亿元

近日，广东省人民政府发布《广东省人民政府关于印发广东省制造业高质量发展“十四五”规划的通知》（以下简称《规划》）。《规划》指出，到2025年，半导体及集成电路产业营业收入突破4000亿元，打造我国集成电路产业发展第三极，建成具有国际影响力的半导体及集成电路产业聚集区。

（资料来源：中国电子报）

半导体设备

【行业】至纯科技全资子公司合肥至汇半导体湿法设备制造项目（一期）将落地合肥，年产能可达40台设备

据合肥经开区网站公告，合肥至汇半导体应用技术有限公司将在合肥经济技术开发区建设半导体湿法设备制造项目（一期），项目总投资1.8亿元，投产后可年产30台年产批次式半导体湿法清洗设备和10台单片式半导体湿法清洗设备。

（资料来源：合肥经开区网站）

【行业】华虹半导体将进一步扩大12英寸产能，Q2产能利用率达109.5%

据华虹半导体披露的财务数据，二季度营收达到历史季度新高3.46亿美元，同比增长53.6%，环比增长13.5%；归母净利润达4408.2万美元，同比增长147.3%，环比增长33.3%；毛利率达24.8%，同比下降1.2个百分点，环比上升1.1个百分点。公司表示，将稳步实现于今年年底达到6.5万片的月生产能力，还将继续加大投入，进一步扩大产能。

（资料来源：华虹半导体公告）

【行业】广东发布重磅规划：“十四五”打造我国集成电路产业发展第三极

据广东省人民政府发布《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》（粤府〔2021〕53号），将围绕巩固提升战略性支柱产业、前瞻布局战略性新兴产业、谋划发展未来产业三大重点发展方向。其中，战略性新兴产业具体包括新一代电子信息，即着力突破核心电子元器件、高端通用芯片，提升高端电子元器件的制造工艺技术水平 and 可靠性，布局关键核心电子材料和电子信息制造装备研制项目，支持发展晶圆制造装备、芯片/器件封装装备3C自动化、智能化产线装备等。

（资料来源：广东省人民政府通知）

半导体材料

【亚洲硅业】亚洲硅业年产4万吨电子级多晶硅项目奠基

8月8日，青海亚洲硅业硅材料有限公司年产4万吨电子级多晶硅项目奠基。

据悉，该项目预计总投资25亿元，预计年实现总产值约40亿元，新增就业1000余人。该项目所生产的超高纯电子级多晶硅，可用于制作满足高效太阳能电池和集成电路等半导体器件标准的单晶硅片。该项目的顺利实施，将进一步增强区域光伏产业上下游互补性，使产业布局更趋合理，创新创业平台更加完善。

下一步，西宁经济技术开发区将牢固树立小二服务理念，认真落实包保责任制，主动做好要素保障和项目协调服务，努力营造项目建设和企业发展良好环境。

（资料来源：青海新闻网）

晶圆代工

【台积电】晶圆代工“龙头”台积电加入“涨价大军”

据研究机构 Digitimes 援引业内人士透露，作为当今全球半导体领域数一数二的龙头企业台积电近期已通知客户，从8月开始，其为LCD驱动芯片供应商提供的12英寸晶圆制造服务将提价15%~20%。对此情况，业内人士认为，这将促使供应商提高终端客户的芯片报价。值得注意的是，面对上游原材料的涨价及下游旺盛的需求，今年以来，各大功率半导体厂商多在不断上调价格，有分析认为，国内芯片短缺的问题可能会持续到明年。

（资料来源：央广网）

封测

【康佳芯云】打造国内第一存储芯片半导体封测品牌？盐城康佳项目或9月量产

康佳盐城存储芯片封装测试基地于去年3月18日开工。康佳集团总裁周彬表示，项目建成后将成为国内唯一对第三方开放的无人工厂，将为盐城打造面向半导体的高科技产业集群起到标杆性示范作用。

据江苏广电总台5月报道，康佳存储芯片封测项目预计在11月全部投产达效，明年预计销售额达到10个亿。每年销售收入的5%会用于工艺技术的开发以及研发新的存储产品。

（资料来源：集微网）

功率半导体

【华润微】117.5亿元，华润微将在重庆建12英寸功率半导体晶圆产线和封装基地

8月12日，公众号“重庆发布”发文指出，华润微电子控股有限公司（以下简称“华微控股”）决定追加投资42亿元，建设功率半导体封装基地，包含功率封装测试与先进封装测试两大工艺生产线。达产后，功率封装产量达到每月220万颗。

（资料来源：网易）

【斯达半导】斯达半导拟募资35亿元用于多项功率器件扩建项目

8月15日晚，斯达半导发布公告称，拟募资35亿元用于高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目、SiC芯片研发及产业化项目、功率半导体模块生产线自动化改造项目以及补充流动资金。

（资料来源：集微网）

风险提示

疫情影响超预期：新冠疫情仍处于全球蔓延阶段，若新冠疫情影响超预期，可能造成全球系统性风险及行业需求不达预期风险。

半导体设备国产化进程放缓：新一轮设备采购中，因进口品牌已深切感受到来自国产设备替代进口设备的经营压力，进口品牌可能通过降价压制国产设备扩大市场份额。

半导体材料国内市场增速放缓：半导体材料从世界范围来看是个增速较为缓慢的市场，中国市场在过去 5 年中 CAGR 达到了 10%，远高于世界平均水平。若半导体材料进入下行周期，目前国内市场的增速将难以持续。

美国进一步向中国禁售关键半导体设备：由于本土晶圆厂对美国设备的依赖度接近 50%，因此一旦美国对出口至我国的关键半导体设备进行约束，我国本土晶圆厂的建产进度将受到影响。

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

买入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上；
增持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；
中性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；
减持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；
未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；
中性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；
弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；
未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人士，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构：

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
致电香港免费电话：
中国网通 10 省市客户请拨打：10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打：10800 1521065
新加坡客户请拨打：800 852 3392
传真: (852) 2147 9513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
传真: (852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编: 100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371